(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205651 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 7/35 (2018.01) *C09J 179/08* (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/011530

(22) 国際出願日： 2025年3月24日(24.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-054449 2024年3月28日(28.03.2024) JP
特願 2024-134059 2024年8月9日(09.08.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 (JP).

(72) 発明者: 友利 直己 (**TOMORI Naoki**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 (JP).

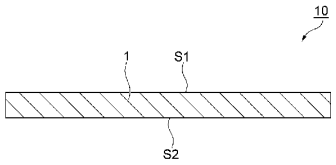
(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外 (**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,

(54) Title: FILM MATERIAL, STRUCTURE, AND WIRING BOARD

(54) 発明の名称： フィルム材、構造体及び配線基板



(57) **Abstract:** The present invention addresses the problem of providing a film material having excellent handleability at room temperature, having sufficient heat resistance, and capable of thermocompression bonding. The present invention is a film material having a first surface S1 and a second surface S2 on the back side thereof. The film material is a resin layer that includes one or more thermocompression bonding layers. The thermocompression bonding layer is non-adhesive at 25 ° C, has thermocompression bonding properties at a higher temperature, by at least 10 ° C, than the glass transition temperature of the thermocompression bonding layer, and does not melt at 250 ° C or lower. The outermost surface layers of both the first surface side and the second surface side of the film material are the thermocompression bonding layers.

(57) 要約：本発明は、常温での取り扱い性に優れ、且つ、十分な耐熱性を有し、熱圧着が可能なフィルム材を提供することを課題とする。 本発明は、第一面Ｓ１及びその裏側の第二面Ｓ２を有する、フィルム材である。当該フィルム材は、１以上の熱圧着層を含み、前記熱圧着層が、２５℃において非接着性で、且つ、熱圧着層のガラス転移温度に対して１０℃以上高い温度において熱圧着性を有し、２５０℃以下で融解しない、樹脂層である。そして、前記フィルム材の第一面側及び第二面側の両方の最表層が熱圧着層である。

WO 2025/205651 A1

［続葉有］

ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）